

ティッシュレベルインプラント ヒーリングアバットメント



補綴プラットフォーム直径	アバットメント直径	高さ		
		2mm	3mm	4mm
φ3.5mm	φ5.0mm	SYHA20	SYHA30	SYHA40
φ4.5mm	φ6.0mm	SGHA20	SGHA30	SGHA40
φ5.7mm	φ7.5mm	SBHA20	SBHA30	SBHA40

- ・ティッシュレベルインプラント専用のヒーリングアバットメントです。0.050" (1.25mm) ヘックスドライバーを使って手指で締結してください。
- ・Titanium Alloy (Ti-6Al-4V)
- ・口腔内で識別が簡単にできるレーザーマーキング。左側のSがティッシュレベルインプラント用の記号、真ん中のアルファベットが補綴プラットフォーム直径、右側の数字が高さです。